

# 芯原微电子（上海）股份有限公司

## 2025 年度“提质增效重回报”行动方案

芯原微电子（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）致力于提高上市公司质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感。自公司 2024 年 3 月制定 2024 年度“提质增效重回报”行动方案以来，公司始终聚焦主业、不断提升经营效率、规范治理、加强投资者沟通和回报。为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司及全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，公司制定了 2025 年度“提质增效重回报”行动方案，切实履行上市公司的责任和义务，进一步提升公司经营效率，构建良好的资本市场形象，共同促进科创板市场平稳运行。

现将公司对 2024 年度“提质增效重回报”行动方案进展执行的评估情况及 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的主要措施公告如下：

### 一、2024 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况

自公司制定 2024 年度“提质增效重回报”行动方案以来，公司持续推进核心技术的研发迭代，以保持技术先进性和核心竞争力，并始终关注市场趋势和技术发展动向，针对目标和关键市场，积极开展新技术的研发，进一步提升公司的科技创新能力和核心竞争力。具体如下：

#### （一）持续核心技术研发，不断迭代升级

公司在持续优化迭代现有核心技术的基础上，于报告期内进一步就生成式人工智能（AIGC）、数据中心、智驾系统、智慧可穿戴设备、物联网这几个关键应用领域，以及 Chiplet 技术进行深入的技术研发和产业化推进。

##### 1) AIGC 应用领域

截至报告期末，芯原全球领先的 NPU IP 已在 82 家客户的 142 款芯片中获

得采用，覆盖服务器、汽车、平板电脑、智能手机、智能家居、可穿戴设备等 10 余个市场领域。目前集成了芯原 NPU IP 的 AI 类芯片已出货超过 1 亿颗。报告期内，芯原最新一代 NPU 架构针对 Transformer 类模型进行了优化，既能高效运行 Qwen、LLAMA 类的大语言模型，也能支撑 Stable Diffusion、MiniCPM 等 AIGC 和多模态模型。芯原的 NPU 还与自有的众多处理器 IP 深度集成，形成包括 AI-ISP、AI-Display、AI-VPU、AI-GPU、AI-DSP 在内的众多 AI 加速子系统解决方案。基于其可编程、可扩展特性，以及自有的创新 NeuroBrick 片上硬件加速解决方案，芯原的 NPU IP 还可针对不同应用场景极大优化客户芯片的 PPA 特性。

公司基于约 20 年 Vivante GPU 的研发经验，所推出的 GPGPU IP 可提供从低功耗嵌入式设备到高性能服务器的计算能力，以高度可扩展的 IP 核重新定义了计算市场，以满足广泛的人工智能计算需求。报告期内，芯原的 GPU 和 GPGPU-AI IP 在全球范围内获得了多次架构授权，在众多高性能计算产品中获得应用。报告期内，公司还推出了全新 Vitality 架构的 GPU IP 系列，集成了诸多先进功能，如一个可配置的张量计算核心（Tensor Core）AI 加速器和一个 32MB 至 64MB 的三级（L3）缓存，提供强大的处理能力和出色的能效表现，并支持多核扩展，广泛适用于云游戏、AI PC、独立显卡和集成显卡等应用领域。

针对 AIGC 产业所面临的安全性和隐私性等问题，芯原还与谷歌合作以支持其新推出的开源项目 Open Se Cura。该项目是一个由设计工具和 IP 库组成的开源框架，旨在加速安全、可扩展、透明和高效的人工智能系统的发展。作为该项目基础设施的一部分，报告期内，芯原开发了多款面向特定应用的平台级解决方案，支持超低功耗空间计算，并提供优质、高效的 AIGC 输入（Token）。目前公司还正在进行基于 Chiplet 架构、面向 AIGC 应用的高性能计算芯片项目的研发。

## 2) 数据中心领域

芯原的视频转码加速解决方案已获得中国前 5 名互联网企业中的 3 家，以及全球前 20 名云服务提供商中的 12 家的采用。目前，公司面向数据中心应用的视频转码平台项目进展顺利，第一代平台已于 2021 年第二季度完成研发工作，并

以 IP 授权、一站式芯片定制业务等方式获得多家客户的采用，已完成适配并陆续量产；目前，基于芯原 IP 的第二代视频转码平台一站式芯片定制项目（包括软硬件协同验证）已基本完成，该平台在原有的技术基础上将不同格式视频转码能力增强到 8K，增加了对 AV1 格式的支持，并新增了 AI 处理能力，此外，还增加了高性能的多核 RISC-V CPU 和硬件的加密引擎。

报告期内，芯原推出面向下一代数据中心的全新 VC9800 系列 IP，该系列 IP 具备高性能、高吞吐量和服务器级别的多码流编解码能力，可支持最高 256 路码流，并兼容所有的主流视频格式，包括新一代先进格式 VVC 等；该系列 IP 还可针对 AI 计算，与芯原的 NPU IP 实现无缝交互，达到了 OpenCV 级别的精度，并在视频处理子系统中引入了超分辨率技术，大幅提升了图像质量，可满足包括视频转码服务器、AI 服务器、云桌面和云游戏等在内的下一代数据中心的先进需求。

### 3) 汽车电子领域

公司已耕耘多年，从座舱到自动驾驶技术均有布局。芯原的 GPU IP 已经在汽车上获得了广泛的应用，包括信息娱乐系统、仪表盘、车身环视、驾驶员状态监控系统、ADAS、自动驾驶汽车等。多家全球知名的汽车 OEM 厂商都采用了芯原的 GPU 用于车载信息娱乐系统或是仪表盘；芯原的神经网络处理器 IP 也已经获得了多家客户用于其 ADAS 产品；芯原的第一代 ISP IP 已获得 ISO 26262 汽车功能安全标准认证和 IEC 61508 工业功能安全标准认证。报告期内，芯原的第二代 ISP 系列 IP 通过了 ISO 26262 ASIL B 和 ASIL D 认证；芯原的畸变矫正处理器 IP 通过了 ISO 26262 ASIL B 认证；芯原的显示处理器 IP 获得了 ISO 26262 ASIL B 认证，公司其他 IP 也正在逐一通过车规认证的进程中，并预计将在近期陆续通过各类车规认证。报告期内，公司的各类处理器 IP 获众多汽车芯片企业采用，例如，合肥杰发科技有限公司在其新一代智能座舱域控 SoC AC8025 中采用了芯原的高性能 IP 组合，包括 NPU IP、VPU IP，以及显示处理器 IP。

公司的设计流程已获得 ISO 26262 汽车功能安全管理体系认证，可从芯片和 IP 的设计实现、软件开发等方面，为全球客户满足功能安全要求的车载芯片提供一站式定制服务。此外，芯原还推出了功能安全（FuSa）SoC 平台的总体设计

流程，以及基于该平台的 ADAS 功能安全方案，并搭建了完整的自动驾驶软件平台框架。报告期内，公司已为某知名新能源汽车厂商提供基于 5nm 车规工艺制程的自动驾驶芯片定制服务，正在积极推进智慧出行领域 Chiplet 解决方案平台研发。基于上述技术布局，芯原正在与一系列汽车领域的关键客户进行深入合作。

#### 4) 智慧可穿戴设备领域

芯原从数年前就开始与该领域领先的企业合作，利用自身低功耗技术方面的优势，积极布局蓝牙耳机、智能手表/手环和基于虚拟现实技术的智能眼镜，并已在芯片和终端产品中验证了芯原面向低功耗应用所打造的 nano 和 pico 系列低功耗 IP 组合。芯原还拥有面向 AR/VR 领域的极低功耗高性能芯片设计平台，可以打造适应不同功率模式的产品，满足超轻量实时在线、低功耗以及全性能的全场景应用。截至报告期末，已有超过 20 家核心智能手表芯片客户采用了芯原的 IP，并广泛应用于市面在售的各类主流智能手表品牌中。芯原正在着力 AI/AR 眼镜的技术平台优化和产业化，除了已为某知名国际互联网企业提供 AR 眼镜的芯片一站式定制服务之外，还有数家全球领先的 AI/AR/VR 眼镜客户正在与芯原进行合作。

芯原以自有的低功耗 IP 为核心基础，结合自身的软件和系统平台设计能力，还推出了一系列从芯片设计到参考应用的一体化可穿戴式健康监测平台级解决方案，可为客户提供含 BLE 协议栈、软件 SDK、算法、智能硬件和应用程序等在内的不同层级的授权和定制设计服务，以期推动可穿戴设备在大健康领域的广泛应用。

此外，芯原正在全面搭建基于芯原技术的可穿戴系统生态。报告期内，专注于提供图形用户界面（GUI）软件服务的趣戴科技（QDay Technology）宣布加入芯原的全球手表 GUI 生态系统，双方共同开发适用于各种应用的智能手表 GUI 解决方案。芯原还与嵌入式系统领域领先的开源图形库 LVGL 达成战略合作，在 LVGL 库中支持芯原的低功耗 3D 和 VGLite 2.5D GPU 技术，旨在为广泛的嵌入式应用提供优化和扩展的图形处理能力；低功耗 AIoT 芯片设计厂商炬芯科技股份有限公司是首批采用这一解决方案的企业之一，其智能手表系统级芯片结合

芯原低功耗 GPU 技术与 LVGL 图形库，提升新一代可穿戴设备的用户体验。

#### 5) 物联网领域

芯原持续优化和丰富自有的物联网无线连接技术平台。公司持续拓展其在 22nm FD-SOI 工艺上的射频类 IP 产品及平台方案布局，包括支持双模蓝牙、低功耗蓝牙 BLE、NB-IoT、多通道 GNSS 及 802.11ah 等物联网连接技术。目前上述所有射频 IP 已经完成 IP 测试芯片的流片验证，大部分已在客户芯片中与基带 IP 集成，形成完整的连接技术方案，应用于智能家居、智能穿戴、高精度定位等领域。

报告期内，芯原持续推进公司物联网无线连接技术的升级以增强市场竞争力，包括：芯原的低功耗蓝牙整体 IP 解决方案已全面支持蓝牙技术联盟（Bluetooth SIG）发布的 LE Audio 规范，其中包括通过了 LE Audio 协议栈和 LC3 编解码器的认证，该方案适用于手机、包括真无线立体声（TWS）耳机在内的蓝牙耳机、音箱及其他广泛的音频应用场景；芯原与无线通信技术和通信芯片提供商新基讯已正式达成战略合作，芯原将能够为客户同时提供 4G 和 5G Modem IP 解决方案，进一步丰富了其无线通信 IP 产品组合，双方还将为客户提供一系列完整的终端系统参考设计，包含射频收发器和电源管理套片等关键组件。未来芯原将继续拓展相关 IP 种类，将陆续推出包括 LTE-Cat1 和 Wi-Fi6 在内的更多高性能射频 IP 产品及方案，支持更丰富的物联网连接应用场景。

FD-SOI 技术以其低功耗、高性能、高集成度的优势，在物联网领域获得了广泛应用。公司已深入布局 FD-SOI 技术多年。截至报告期末，公司在 22nm FD-SOI 工艺上开发了超过 60 个模拟及数模混合 IP，种类涵盖基础 IP、数模转换 IP、接口协议 IP 等，已累计向 42 个客户授权了 290 多个/次 FD-SOI IP 核；并已经为国内外知名客户提供了 41 个 FD-SOI 项目的一站式设计服务，其中 31 个项目已经进入量产。报告期内，公司还基于 FD-SOI 的低功耗技术优势，持续开发针对如 Wi-Fi6、卫星通信、毫米波雷达和助听器等应用的技术平台。

#### 6) Chiplet 技术

Chiplet 技术及产业化是芯原的发展战略之一，公司已于五年前开始布局

Chiplet 技术的研发。目前，公司正在以“IP 芯片化（IP as a Chiplet）”、“芯片平台化（Chiplet as a Platform）”和“平台生态化（Platform as an Ecosystem）”理念为行动指导方针，从接口 IP、Chiplet 芯片架构、先进封装技术、面向 AIGC 和智慧出行的解决方案等方面入手，持续推进公司 Chiplet 技术、项目的发展和产业化，持续提升公司半导体 IP 授权和芯片定制业务的产业价值，拓展市场空间。

截至报告期末，公司已在基于 Chiplet 的生成式人工智能大数据处理和高端智驾两大赛道实现领跑，目前正在推进基于 Chiplet 架构、面向智驾系统和 AIGC 高性能计算的芯片平台研发项目。目前公司在 Chiplet 领域取得的切实成果包括：已帮助客户设计了基于 Chiplet 架构的 Chromebook 芯片，采用了 SiP（System in Package）先进封装技术，将高性能 SoC 和多颗 IPM 内存合封；已帮助客户的 AIGC 芯片设计了 2.5D CoWos 封装；已设计研发了针对 Die to Die 连接的 UCIe 物理层接口，相关测试芯片已流片，即将返回进行封装和测试；已和 Chiplet 芯片解决方案的行业领导者合作，为其提供包括 GPGPU、NPU 和 VPU 在内的多款芯原自有处理器 IP，帮助其部署基于 Chiplet 架构的高性能人工智能芯片，该芯片面向数据中心、高性能计算、汽车等应用领域。此外，为了应对先进封装技术可能出现的供应和成本等问题，芯原已针对新一代面板级封装（Panel level package）技术进行了先行设计开发，为接下来的规模量产做好了准备。本土封装厂也正在积极布局该封装技术，芯原将与之携手，共同打造更具成本效益且供应安全的先进封装解决方案。

## （二）人才培养

坚持引进和培养优秀人才是公司生存和发展的关键，也是公司持续提高核心竞争力的基础。

根据长期技术发展战略和现有人才储备情况，在引进外部人才方面，公司不仅通过内部推荐、网络招聘等各种方式招募有经验的优秀人才，也通过每年线上校园招聘、“芯原杯”全国嵌入式软件开发大赛、“芯原杯”电路设计大赛、与各大重点高校联合开展技术讲座，搭建“海南大学-芯原智慧医养创新实验室”、“海南大学生物医学工程学院-芯原医疗电子创新实验室”、“浙江大学-芯原智能图形处理器联合研究中心”，以及成为东南大学信息科学与工程学院和海南大学生

物医学工程学院的校外实习基地等，以此来吸引并招募国内外顶尖高校的毕业生，为公司持续稳定发展提供人才储备。

在内部人才培养方面，公司不断实行完善有效的培养方案和公开透明的晋升机制，包括通过线上线下的技术和管理培训，提高员工的综合发展能力；积极营造良好的工作环境，从企业文化、薪酬福利、人才激励等方面提高员工的凝聚力。

截至2024年12月末，公司研发人员合计1,800人，研发人员的占比为89.37%，研发人员中硕士及以上学历人员占比达88.61%。公司中国大陆地区具有十年以上工龄的员工占比为26%，员工平均年龄为32岁。基于上述行业及公司特征，公司的研发能力一直保持在较高水平，建立了理论知识扎实、研发实力强、经验丰富的研发团队，保持了业务的竞争优势，从而打造了高竞争壁垒。

2023年全行业面临严峻挑战，应届毕业生就业形势不容乐观，公司通过合理的薪酬吸纳优秀毕业生，为未来的技术研发储备人才。2023年下半年，公司招聘的500多名应届毕业生，相关人员均拥有硕士及以上学历，其中硕士985、211院校占比94%，硕士985院校占比70%。2024年下半年招聘的200多名应届毕业生中，硕士985、211的占比为97%，其中本硕都是985、211的占比85%。得益于公司优异的招聘质量和高效的培训机制，2023年招聘的应届毕业生对今年已经展开和正要承接的多个芯片大项目提供了必要的人力资源。

公司基于对行业周期的判断，一定规模人才储备能够帮助公司在竞争中抢占先机，吸引和培养未来的核心人才，增强企业的竞争力。公司逆势招聘优秀专业人才的战略有助于在行业复苏时快速抓住市场复苏机遇，实现收入增长。

得益于公司优秀的企业文化，公司人才稳定性保持于较高水平，2023年，芯原中国大陆地区员工主动离职率为2.8%，远低于中国大陆半导体行业平均约16.5%的主动离职率；2024年，芯原中国大陆地区员工主动离职率为2.1%，远低于中国大陆半导体行业平均约9.4%的主动离职率（怡安翰威特人力资本调研数据）。

### **（三）资源整合**

公司作为集成电路设计企业和制造企业之间的桥梁，在整个产业链中具有重

要的沟通和衔接作用，因为对整个产业链的全局发展有着较为全面的认知。基于此，公司积极推动产业的生态建设，2024 年度，公司组织并承办了多个行业论坛及研讨会，包括：

- 第十四届芯原 CEO 论坛：以“Chiplet 的发展机遇”为主题，共邀请了约 40 位来自芯片设计、系统设计、研究机构、投资机构等相关产业链的决策者出席，会议就“Chiplet 应用前景”和“Chiplet 技术发展趋势与展望”两个话题展开了深入讨论；

- 第十四届松山湖中国 IC 创新高峰论坛：公司作为主办方之一，联合中国半导体行业协会集成电路设计分会等创办了松山湖论坛，已将其打造成为全国最具影响力的本土创新 IC 集中发布平台。本届会议重点推广了 10 款代表中国先进 IC 设计水平，与“智慧机器人”应用需求紧密结合的 IC 新品。该会议为闭门会议，邀请了 140 余位嘉宾线下出席，线上超过 12000 人观看了直播。会议当天媒体原创报道达 90 篇，会后总数超过 140 篇；

- “链聚浦东·芯启未来”RISC-V 产业技术研讨会暨 RISC-V 专利导航成果发布会：本次会议由上海市浦东新区科技和经济委员会指导，公司和上海开放处理器产业创新中心共同主办，中国 RISC-V 产业联盟(CRVIC)、RISC-V 专利联盟(RVIA)和上海市集成电路行业协会 RISC-V 专委会等单位和机构协办。会议交流了 RISC-V 产业的发展情况，分享了 RISC-V 产业专利导航的最新成果，旨在推动 RISC-V 生态的繁荣健康发展；

- 从云到端，AI 触手可及-芯原 AI 专题技术研讨会：聚焦大模型时代 AI 技术从云端到边缘端的最新发展趋势，来自乌镇智库、南京蓝洋智能科技有限公司、神顶科技（南京）有限公司、电子科技大学等产学研界的嘉宾，与芯原一同探讨了大模型在边缘端部署的机遇、挑战和实践案例，以及集成电路如何布局 AI 应用的长远发展；

- “智”由“芯”生——RISC-V 和生成式 AI 论坛：由公司和上海开放处理器产业创新中心联合主办，于 2024 世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议（WAIC 2024）同期在上海世博中心举办，深入探讨了 RISC-V 与生成

式 AI 融合发展的技术趋势、市场机遇，并就前沿技术及应用案例进行了分享；

- 第四届滴水湖中国 RISC-V 产业论坛：由上海开放处理器产业创新中心和公司共同主办。会议推介了 10 款本土 RISC-V 芯片产品，并探讨了 RISC-V 在边缘计算领域的发展机遇。该会议为闭门会议，邀请了 180 余位嘉宾线下出席，超过 17000 人线上观看了直播。会议当天媒体原创报道达 77 篇，会后媒体原创报道总数达百余篇；

- 第九届上海 FD-SOI 论坛：由公司、新傲科技和新傲芯翼主办，SEMI 中国和 SOI 国际产业联盟协办。邀请了约 300 位来自衬底、晶圆厂、IDM、芯片设计公司和系统厂商等 FD-SOI 产业链的海内外重要嘉宾齐聚一堂，共同探讨了 FD-SOI 工艺的技术优势和发展趋势，以及 FD-SOI 的设计实现；

- 第三届南渡江智慧医疗与康复产业高峰论坛：由海口市科学技术工业信息化局和公司主办，芯原微电子(海南)有限公司承办，聚焦数字疗法、脑机接口和康复机器人三个议题。该会议为闭门会议，邀请了 170 余位嘉宾线下出席，近万人线上观看了直播。会议当天媒体原创报道达 107 篇，会后媒体原创报道总数超过 130 篇。

#### **(四) 完成再融资发行，募投项目研发布局稳步开展**

2023 年 12 月，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过 2023 年度向特定对象发行股票事项（以下简称“再融资”），募集资金投资投向为“AIGC 及智慧出行领域 Chiplet 解决方案平台研发项目”和“面向 AIGC、图形处理等场景的新一代 IP 研发及产业化项目”。自公司制定 2024 年度“提质增效重回报”行动方案以来，公司再融资项目稳步推进，相关发行 A 股股票申请已于 2025 年 2 月通过上海证券交易所审核，并于 2025 年 3 月收到中国证监会的注册批文。

2024 年内，公司已根据上述募投项目实施安排开始投入研发工作，目前已稳步取得阶段性进展，相关研发工作将持续推进。公司董事会将按照注册批文和相关法律法规的要求以及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票的相关事项。

本次募集资金投资项目紧紧围绕公司主营业务展开，是在公司现有业务与技

术成果的基础上的升级与扩充，将为公司实现中长期战略发展目标奠定坚实的基础。通过再融资募投项目的实施，公司将进一步丰富公司技术矩阵、提升产品性能、完善下游应用市场布局、探索前沿技术研究，以满足公司研发布局与业务扩张需求，持续强化公司的科创实力。

### **（五）优化运营效率，在手订单长期保持高位**

自公司制定 2024 年度“提质增效重回报”行动方案以来，公司持续优化研发、存货、应收账款、资金等事项的运营管理，定期与管理层就上述重点运营事项汇报讨论，以增加运营效率。未来，公司仍将重点加强应收账款情况的实时监控、逾期催收等工作，进一步提高回款速度，持续提升公司经营效率以及资金效率。

公司持续深化与各领域头部企业的合作广度与深度，基于芯原的半导体 IP、芯片定制硬件、软件平台的技术赋能能力，持续提升芯原在相关领域中的地位与价值。2024 年度，公司半导体 IP 授权服务新增客户数量 33 家，截至报告期末累计半导体 IP 授权服务客户总数量超 445 家；一站式芯片定制服务新增客户数量 12 家，截至报告期末累计一站式芯片定制服务客户总数量超 330 家。截至 2024 年末，公司订单情况良好，在手订单 24.06 亿元，较三季度末的 21.38 亿元进一步提升近 13%，在手订单已连续五季度保持高位。从新签订单角度，2024 年第四季度公司新签订单超 10.8 亿元，2024 年下半年新签订单总额较 2024 年上半年提升超 50%，较 2023 年下半年同比提升超 48%，较半导体行业周期下行及去库存影响下的 2023 年上半年大幅提升超 80%，对公司未来的业务拓展及业绩转化奠定坚实基础。

公司高度重视业务和市场发展绩效，持续坚定拓展目标市场，履行国际化发展战略，2024 年，公司来源于境外的收入金额为 8.69 亿元，占公司营业收入总额的 37.43%。

### **（六）完善公司治理结构**

自公司制定 2024 年度“提质增效重回报”行动方案以来，公司不断健全公司治理结构，对内控体系进行完善，完成了项目立项流程优化等工作，提升公司

治理水平，为公司股东合法权益的保护提供有力保障。公司董监高积极参与了监管机构 and 行业协会举办的多项培训，加强学习证券市场相关法律法规，熟悉证券市场知识，推动公司持续规范运作。

公司严格管理募集资金使用，确保募集资金按照既定用途得到充分有效利用。基于智慧汽车的 IP 应用方案和系统级芯片定制平台的开发及产业化项目以及研发中心建设项目的实施安排，上述项目已分别于 2024 年 6 月及 2024 年 11 月完成并结项。

### **（七）加强与投资者的沟通**

公司始终重视与广大投资者的交流互动，并致力于维护良好的投资者关系。公司积极与广大投资者沟通公司经营情况，分别于 2024 年 4 月 1 日、2024 年 8 月 9 日、2024 年 10 月 31 日在上证路演中心平台召开了 2023 年年度、2024 年半年度、2024 年第三季度业绩说明会。公司 2024 年内已举办了 18 场投资者关系活动，完成 47 个“上证 e 互动”平台问题回复，并参加了上交所主办的走进上市公司活动，通过各种形式与投资者积极沟通，加深投资者对于公司经营情况的了解，增强投资者对公司的认同感，增进交流互信，树立市场信心。此外，公司于 2024 年 3 月 30 日发布了《2023 年社会责任报告》，向社会公众及投资人全面展示公司积极履行 ESG 管治的责任和义务，在社会责任、员工关怀等方面的表现，有助于市场更充分的了解公司经营和发展情况。

### **（八）完善投资者回报机制**

公司将持续根据公司于 2023 年 12 月制定并披露的《未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》，着眼于公司的长远和可持续发展，综合考虑公司未来战略发展目标，结合公司经营情况与发展规划，严格执行分红政策，在符合条件的情况下积极推动对广大股东的利润分配以及现金分红，强化对投资者的回报机制。

### **（九）强化管理层与股东的利益共担共享约束并强化“关键少数”的责任，管理层承诺不减持**

基于对公司未来发展的信心以及对公司长期价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展，维护资本市场的稳定，切实保护全体股东利益，公司董事长兼

总裁 Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）先生，董事、副总裁 Wei-Jin Dai（戴伟进）先生，董事、副总裁、首席财务官、董事会秘书施文茜女士，副总裁汪洋先生，副总裁汪志伟先生，原副总裁 Martyn Humphries 先生自愿承诺自 2024 年 2 月 5 日起 6 个月内不减持上述其所持有的公司股份，包括承诺期间该部分股份因公司送红股、转增股本、配股等原因而增加的股份。

公司管理层严格遵守自愿承诺，上述期间内未减持其所持有的公司股份，且基于管理层与股东的利益共担原则，公司 2024 年度高管团队薪酬有所压降，与股东风险共担。

## 二、2025 年度“提质增效重回报”行动方案主要措施

### （一）聚焦主营业务，提升科技创新能力

公司是一家依托自主半导体 IP，为客户提供平台化、全方位、一站式芯片定制服务和半导体 IP 授权服务的企业。自 2001 年设立以来，公司始终深耕主营业务，作为全球领先的半导体 IP 授权服务提供商和芯片定制服务提供商，目前拥有包括图形处理器（GPU）IP、神经网络处理器（NPU）IP、视频处理器（VPU）IP、数字信号处理器（DSP）IP、图像信号处理器（ISP）IP、显示处理器 IP 六类处理器 IP，以及 1,600 多个数模混合 IP 和射频 IP。根据 IPnest 在 2024 年 5 月的统计，2023 年，芯原半导体 IP 授权业务市场占有率位列中国第一，全球第八；2023 年，芯原的知识产权授权使用费收入排名全球第六。根据 IPnest 的 IP 分类和各企业公开信息，芯原 IP 种类在全球排名前十的 IP 企业中排名前二。除了丰富的半导体 IP 外，公司还具有领先的芯片设计能力，拥有从先进的 5nm FinFET 到传统的 250nm CMOS 工艺节点芯片的设计能力。在先进半导体工艺节点方面，公司已拥有 14nm/10nm/7nm/6nm/5nm FinFET 和 28nm/22nm FD-SOI 工艺节点芯片的成功流片经验，目前已实现 5nm 系统级芯片一次流片成功，多个 5nm/4nm 一站式服务项目正在执行。

2025 年度，公司将深耕主营业务，聚焦半导体 IP 业务以及一站式芯片定制业务领域，实施优化提升举措，持续加固核心业务的竞争优势，稳步拓展市场占有率，夯实行业领军地位；此外，公司将紧密依循短、中、长期发展战略规划进

行研发布局，以创新驱动为关键支撑，推动公司业绩增长。具体措施如下：

### 1、技术研发

在半导体 IP 业务方面，持续优化和丰富半导体 IP 产品系列，包括公司核心的图形处理器 IP、神经网络处理器 IP、视频处理器 IP、数字信号处理器 IP、图像信号处理器 IP 和显示处理器 IP 六类处理器 IP，以及 1,600 多个数模混合 IP 和物联网无线连接 IP（含射频）；基于自有的处理器 IP，推出创新的 AI-ISP、AI-Display、AI-VPU、AI-GPU、AI-DSP 等系列 AI 加速子系统解决方案，进一步扩大公司 IP 在 AI 应用领域的深度和广度；针对关键应用领域如 AIGC、数据中心、汽车、智慧可穿戴、物联网等的应用特点，进行技术优化和组合，以平台化的 IP 解决方案强化公司 IP 产品的竞争优势。

在一站式芯片定制业务方面，持续优化基于先进生产工艺的芯片设计与验证方法；继续推进 Chiplet 相关技术和项目的设计实现与产业化，包括关键功能模块 Chiplet、Die-to-Die 接口、Chiplet 芯片架构、先进封装技术、面向 AIGC 和汽车智驾系统的 Chiplet 芯片设计项目等；结合软件团队的优势，实现系统平台解决方案如数据中心视频转码、AI/AR 眼镜、自动驾驶/ADAS 等平台项目的产业化落地；加深与大型互联网企业、云服务提供商、车企等客户的合作，共同打造和完善按应用领域划分的系统生态等。

### 2、人才培养

人才是公司发展的重要资源。随着公司临港研发中心的建成，公司上海研发布局已经由张江高科技园区单研发中心布局扩张至张江及临港双研发中心布局，有助于公司招募到更多优秀的人才以保持公司技术先进性，加快技术人才体系建设并完善公司战略布局。公司将根据未来发展战略目标，通过优质的校园招聘和社会招聘，引进相关的优秀人才。公司将通过进一步优化人力资源管理体系，如强化企业文化，制定科学高效的培训制度等，来提升员工的企业归属感和加强公司的人才梯度建设。公司还将不断优化绩效管理体系、依托资本市场制定长效的股权激励计划，充分调动员工的积极性，为公司创造更多价值。

### 3、资源整合

公司以芯片设计服务为主要业务，作为集成电路设计企业和制造企业之间的桥梁，在整个产业链中具有重要的沟通和衔接作用，因此对整个产业链的全局发展有着较为全面的认知。公司将充分利用这一优势，积极推进产业链上下游的合作，推动产业的生态建设，加强产业间的融合，提升公司的产业地位和整体竞争力。同时，公司还将继续依托自身平台化公司对行业发展趋势的全面理解，视业务需要择机进行与公司战略发展方向相一致的投资或并购。

## **（二）优化运营效率**

公司始终高度重视业务与市场开拓，将积极拓展目标市场，全面履行国际化发展战略布局。得益于公司丰富的订单储备及优质客户资源，公司将进一步深化与各领域头部企业的合作广度与深度，充分发挥公司技术实力及创新能力，全方位提升芯原在相关领域的行业地位与核心价值。2025 年度，公司将结合自身发展战略与产业发展趋势，进一步优化公司的业务布局和运营效率，逐步提升盈利能力。此外，公司仍将坚持通过持续优化研发、存货、应收账款、资金等事项的运营管理，重点加强应收账款情况的实时监控、逾期催收等工作，进一步提高回款速度，提升公司经营效率以及资金效率。

## **（三）按计划推进募投项目投入，加强募集资金管理**

2025 年度，公司将结合募投项目规划及市场情况逐步推进募投项目的研发投入，助力公司在 AIGC 及智慧出行领域中 Chiplet 技术以及新一代 IP 研发布局。公司将严格执行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件以及《芯原微电子（上海）股份有限公司章程》《芯原微电子（上海）股份有限公司募集资金管理办法》的规定，开设专户存储，严格管理募集资金使用，确保募集资金按照既定用途得到充分有效利用。公司、保荐机构、存管银行将持续对公司募集资金使用进行检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。

## **（四）完善内部控制体系建设**

2025 年度，公司将进一步健全公司治理结构，优化业务流程，并结合法律

法规的更新以及公司实际情况，全面梳理公司现有内部控制制度，不断对内控体系进行完善，明确相关部门人员的职责和权限，持续深入开展治理活动，提升公司治理水平，为公司股东合法权益的保护提供有力保障。

### **（五）制定《市值管理制度》，加强与投资者的沟通**

公司始终重视通过多维度与广大投资者沟通交流，建立了公开、公平、透明的投资者沟通渠道，并致力于维护良好的投资者关系。2025 年度，公司将继续通过业绩说明会、投资者邮箱、投资者专线、“上证 e 互动”平台等各种形式与广大投资者沟通，同时将积极通过图文简报等可视化形式对年度报告等定期报告进行解读，提高可读性，以加深投资者对于公司经营情况的了解，增强投资者对公司的认同感，增进交流互信，树立市场信心。

为加强公司市值管理，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，维护投资者利益，根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，公司制定了《市值管理制度》，以提高公司质量为基础，践行“以投资者为本”的发展理念，增强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理反映公司质量。

### **（六）完善投资者回报机制**

2025 年度，公司将进一步根据公司 2023 年 12 月制定的《未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》，综合考虑公司未来战略发展目标的基础上，兼顾各类股东意愿，结合公司的盈利情况和现金流量状况、经营发展规划及企业所处的发展阶段、资金需求情况、社会资金成本以及外部融资环境等因素，依据《公司章程》的要求，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，并对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的合理性、连续性和稳定性。公司将根据经营情况与发展规划，严格执行分红政策，在符合条件的情况下积极推动对广大股东的利润分配以及现金分红，强化对投资者的回报机制。

### **（七）强化管理层与股东的利益共担共享约束并强化“关键少数”的责任**

公司推崇全员持股理念，重视员工的归属感，鼓励员工和公司共发展。公司于科创板上市后，推出了 2020 年限制性股票激励计划及 2022 年限制性股票激励

计划，通过实施上述股权激励计划，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，促进公司核心人才队伍的建设和稳定，从而有助于公司长远发展，维护股东权益。

公司始终重视“关键少数”在公司生产经营过程中的重要作用，持续强化“关键少数”的履职责任。2025年度，公司将完成新一届董事会及高管团队的换届工作，公司将督促“关键少数”积极参与上交所等监管机构举办的各种培训，加强学习证券市场相关法律法规，熟悉证券市场知识，及时传达最新监管精神、处罚案例、市场动态等信息，强化“关键少数”合规意识，推动公司持续规范运作。

公司制定了科学合理的薪酬机制，董事会薪酬与考核委员会负责研究并监督对公司高级管理人员的激励、考核和方案实施。2025年度，董事会薪酬与考核委员会将结合公司经营情况、战略发展等目标的综合完成情况对公司高级管理人员进行绩效业绩考核，确保高级管理人员的薪酬水平与工作职责、业绩考核以及公司经营情况等指标合理挂钩，以强化管理层与股东的利益共担共享。

#### **（八）其他措施**

公司将持续推进“提质增效重回报”行动方案的实施与评估，并及时履行信息披露义务。未来经营中，公司将着力提升精细化管理水平，持续深化主营业务领域布局；强化核心技术研发投入，巩固行业领先地位，逐步提升盈利能力；公司管理层将通过科学决策和高效执行，全面提升企业经营效益与资本市场价值，切实维护股东合法权益。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

芯原微电子（上海）股份有限公司董事会

2025年4月25日

